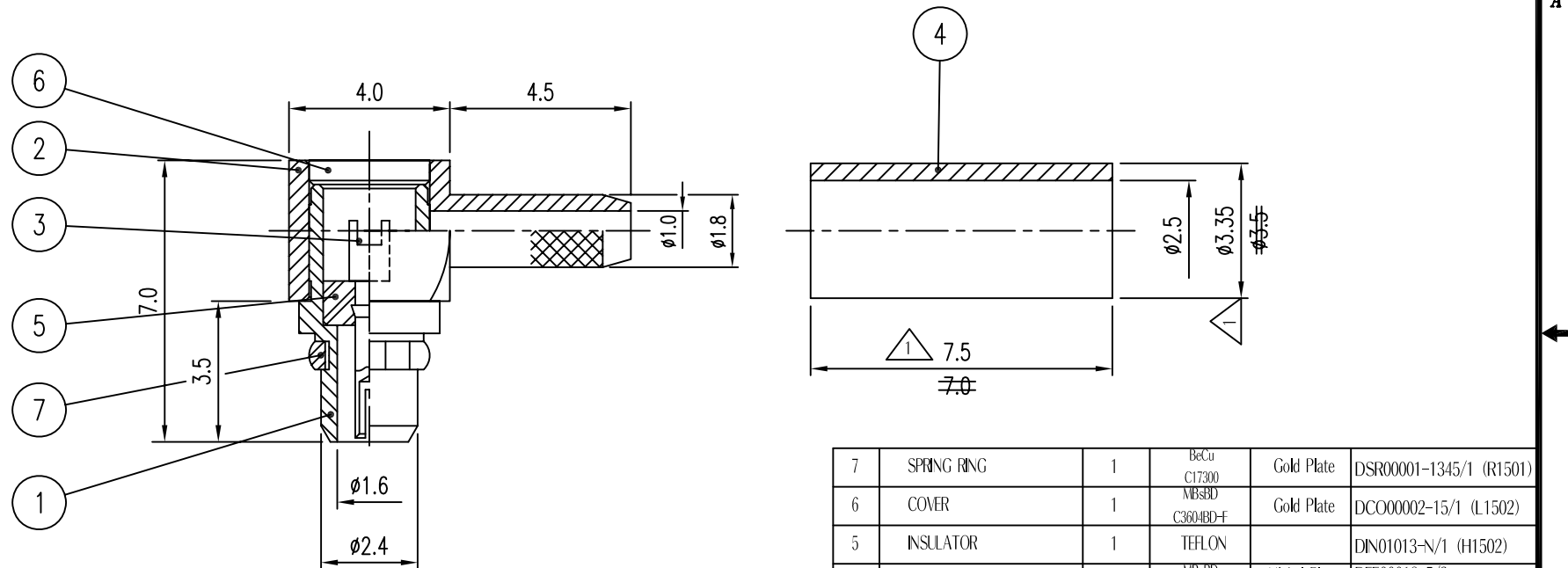


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1	(설번No.202201-0009) 테페 양척 후 BURR 발생 개선으로 인한 테페 변경	은선영	김선호	2022. 01. 10.
ST(개선)														



7	SPRING RING	1	BeCu C17300	Gold Plate	DSR00001-1345/1 (R1501)
6	COVER	1	NBSBD C3604BD-F	Gold Plate	DCO00002-15/1 (L1502)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DN01013-N/1 (H1502)
4	FERRULE	1	NBSBD C3604BD-F	Nickel Plate Gold Plate	DFE00018-5/3 DFE00009-145/1 (E1501)
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00004-1345/1 (E1507)
2	BODY	1	NBSBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00012-135/1 (D1514)
1	BODY	1	NBSBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00003-135/1 (D1513)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2001. 5. 29.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인						
	검도						
재질	재도				도명	MMCX50 CABLE PL RG178	
열처리	작성부서			A4			
연 구 소							
보호피막처리	척도 6/1	단위 mm	중량		도번	CN00013-7/1	
						K311-133-001	